

# SOITEC ANNONCE UN ACCORD COMMERCIAL AVEC QUALCOMM TECHNOLOGIES SUR LES SUBSTRATS POI POUR LES FILTRES RF 5G

## **SOITEC ANNONCE UN ACCORD COMMERCIAL AVEC QUALCOMM TECHNOLOGIES SUR LES SUBSTRATS POI POUR LES FILTRES RF 5G**

*Bernin (Grenoble), France, 7 juillet 2020* – Soitec (Euronext Paris), leader dans la conception et la production de matériaux semi-conducteurs innovants, a annoncé ce jour la signature d'un accord commercial avec Qualcomm Technologies portant sur l'approvisionnement de substrats innovants piézoélectriques-sur-isolant pour les filtres RF 4G et 5G. Le substrat *Piezoelectric-on-Insulator* (POI) de Soitec apporte une forte valeur ajoutée aux filtres 5G des smartphones pour les marchés de masse.

### **Sécuriser l'approvisionnement pour la nouvelle génération de filtres RF de Qualcomm Technologies**

Après plusieurs années de collaboration avec Qualcomm Technologies, Soitec a conclu un accord afin d'augmenter le volume de production des plaques POI qui seront utilisées pour les filtres RF de Qualcomm Technologies destinés aux modules front end RF des smartphones.

*« Grâce à notre technologie disruptive en couches minces et notre innovation dans les filtres RF Qualcomm® ultraSAW, nous continuons à repousser les limites du possible dans la technologie mobile », a déclaré Christian Block, Senior Vice Président & General Manager RFFE, Qualcomm Germany RFFE GmbH. « Cet accord avec Soitec est essentiel pour assurer l'approvisionnement de substrats POI hautes performances de Soitec. Il permet ainsi de répondre à la demande de nos clients OEM en filtres RF Qualcomm ultraSAW hautes performances. L'association du substrat POI de Soitec basé sur sa technologie Smart Cut™ et de l'expertise de Qualcomm Technologies en matière de conception de filtres et de systèmes permet d'obtenir des multiplexeurs à haut rendement avec plusieurs fonctions de filtrage par puce ».*

### **Le substrat POI de Soitec choisi pour sa valeur unique pour les filtres RF**

Le POI est un substrat innovant fabriqué grâce à la technologie brevetée Smart Cut™ de Soitec en 150 mm. À sa base se trouve un substrat de silicium à haute résistivité, agrémenté d'une couche d'oxyde dite enterrée et d'une couche fine et uniforme de matériau piézoélectrique monocristallin sur le dessus. Les substrats POI de Soitec ont été conçus pour fabriquer la dernière génération de filtres 4G/5G à ondes acoustiques de surface (SAW), offrant performance et compensation de température intégrée.

*« Cet accord commercial est le résultat d'une collaboration entre Soitec et Qualcomm Technologies. Nous sommes très satisfaits que les substrats POI de Soitec constituent désormais une part importante de l'offre 5G de Qualcomm Technologies pour les appareils mobiles », a déclaré Dr Bernard Aspar, Senior Executive*

Vice President Global Business Units de Soitec. « Soitec sert depuis longtemps les marchés de la RF, notamment avec des quantités importantes de produits RF-SOI. Nous sommes confiants dans notre capacité à gérer la production de forts volumes afin que le POI devienne un standard pour les filtres RF 5G, grâce à notre technologie Smart Cut™ robuste et éprouvée ».

Qualcomm est une marque de Qualcomm Incorporated, déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.  
Qualcomm ultraSAW est un produit de Qualcomm Technologies, Inc. et/ou de ses filiales.

## A propos de Soitec

Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l'électronique. Avec plus de 3 500 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux États-Unis et en Asie.

Soitec et Smart Cut sont des marques déposées de Soitec

**Pour en savoir plus, veuillez consulter le site [www.soitec.com](http://www.soitec.com) et suivez-nous sur Twitter : @Soitec\_FR.**

<p><b>Contact relations investisseurs :</b></p> <p>Steve Babureck +33 6 16 38 56 27 <a href="mailto:steve.babureck@soitec.com">steve.babureck@soitec.com</a></p>	<p><b>Contacts médias financiers :</b></p> <p>Isabelle Laurent +33 1 53 32 61 51 <a href="mailto:isabelle.laurent@oprfinancial.fr">isabelle.laurent@oprfinancial.fr</a></p> <p>Fabrice Baron +33 1 53 32 61 27 <a href="mailto:fabrice.baron@oprfinancial.fr">fabrice.baron@oprfinancial.fr</a></p> <p><b>Contact médias business :</b></p> <p>Marie Cabrières +33 6 26 70 12 78 <a href="mailto:marie.cabrieres@soitec.com">marie.cabrieres@soitec.com</a></p>		
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

# # #

Soitec est une société anonyme à conseil d'administration au capital de 66 557 802,00 euros, dont le siège social est situé Parc Technologique des Fontaines – Chemin des Franques – 38190 Bernin (France), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 384 711 909.

# # #

## Pièce jointe

- [PR POI\\_SOITEC\\_QUALCOMM AGREEMENT\\_FR](#)